

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2021-043

深南电路股份有限公司

关于签订项目投资合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

鉴于封装基板产品具有广阔的市场前景，为满足公司战略发展目标，提升行业竞争力，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于签订项目投资合作协议的议案》，同意公司与广州开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本投资事项尚需提交股东大会审议。

二、项目投资合作协议的主要内容

（一）合作双方

甲方：广州开发区管理委员会

乙方：深南电路股份有限公司

（二）项目概况

1、项目名称：深南电路FC-BGA封装基板项目。

2、主要产品：FC-BGA、FC-CSP及RF封装基板。

3、项目主要内容：公司拟以2亿元人民币在广州市开发区投资设立全资子公司，并以广州子公司作为项目实施主体，以公司自有资金及自筹资金建设FC-BGA封装基板项目。

4、项目用地：项目用地拟选址于中新广州知识城内，总用地面积约143,400 m²，具体出让面积及其他土地条件以国土部门的出让文件和签订的国有土地使用权出让协议为准，地块出让价格以国土部门委托的第三方机构评估为准。

5、项目规模：项目总投资约人民币60亿元，固定资产投资总额累计不低于58亿元，其中，项目一期固定资产投资不低于38亿元，项目二期固定资产投资不低于20亿元。项目整体达产后预计产能约为2亿颗FC-BGA、300万panel RF/FC-CSP等有机封装基板。

（三）权利与义务

1、甲方的权利和义务

（1）甲方为乙方提供相关手续支持：

甲方为乙方因项目需要设立于广州开发区内的项目公司提供注册地址，并对乙方及项目公司在广州开发区办理各项行政登记手续给予大力支持。甲方在符合国家法律、法规、规章和有关政策文件的规定下支持乙方通过招拍挂公开出让方式依法竞拍建设用地使用权。甲方协调国土管理部门完成项目用地的供地程序。

（2）甲方为乙方提供相关资质支持：甲方积极协助乙方完成项目审批，包括但不限于：

①协助乙方或乙方项目公司办理项目立项、可行性研究和环评、安评、能评等审批手续。

②协助乙方或乙方项目公司办理工商、税务登记、工程报建、土地使用、消防审批等与项目建设相关的手续。

③协助乙方或乙方项目公司处理和解决好筹建和生产过程中涉及当地相关部门管理事务的沟通协调工作。

（3）成立项目工作小组：甲方将成立由区领导任组长的项目工作小组，为项目建设全过程提供优质、高效的服务。

2、乙方的权利和义务

（1）乙方承诺在签订本协议后三个月内成立项目公司，并负责本项目的具体开发建设及运营。项目公司须在广州开发区范围内办理工商登记，并将其税务征管和营收统计关系纳入广州开发区。项目建成运营后在广州开发区实际经营办公。

(2) 乙方须按照相关的法律规定，及时参与竞投投资项目拟使用土地的国有建设用地土地使用权，完成土地“招标、拍卖、挂牌”相关出让手续并及时付清全部地价款及相关税费。

(3) 乙方承诺项目公司将如期兑现本协议约定的固定资产投资、产出承诺。

(4) 乙方承诺项目公司就本协议项下各项义务的履行接受甲方及相关部门的监督，真实、及时地向甲方及相关部门报送项目进展信息，并自愿承担履行本协议、补充协议约定及相关扶持政策文件规定的责任。

(5) 乙方承诺项目公司将依法设立，取得建设和运营所需要的全部资质，遵循相关法律法规规定（包括但不限于环保、税收等规定）进行高效投产运营。

三、投资的目的及对公司的影响

封装基板是集成电路封装的重要材料，为芯片提供支撑、散热和保护，广泛应用于手机、数据中心、消费电子、汽车等领域。

1、封装基板产品具有广阔的市场前景

随着5G建设及应用的逐步推进，数据中心、智能驾驶、AI、高性能计算等领域需求热度持续高涨，其所需的主要核心IC（CPU，GPU，FPGA，ASIC）市场规模迎来高速增长的机会。同时，随着5G手机等终端数量逐年增加，手机等智能终端所需的应用处理器、射频模组等IC需求也稳步增长。封装基板作为集成电路封装的核心材料之一，具有广阔的市场前景。

2、满足公司战略发展目标，提升行业竞争力

公司经过多年的运营，在封装基板领域积累丰富的经验，在不同的半导体下游市场应用领域配套国内外客户需求。建设封装基板项目是公司实现中长期发展目标的重要举措，有利于公司快速抓住市场机遇，加快产业布局，进一步提升公司在高端封装基板市场的竞争力。

本次投资有利于满足公司业务扩展及产能布局的扩张，增强公司的核心竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次投资资金为公司自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的主要风险

1、本协议尚需提交股东大会审议，审议批准后方可生效，公司将按照有关规定履行必要的审批程序并及时发布进展公告。

2、项目实施主体还需根据相关法律、法规、规范性文件的规定，履行必要的审批程序；公司尚需通过招拍挂等公开出让方式按程序合法竞拍本项目用地的土地使用权，公司将积极参与政府的土地招拍挂公开程序，但竞拍结果具有不确定性；项目开工建设及生产经营需要通过立项、环评、安评、能评等相关行政许可。

3、受国家或地方有关政策调整、宏观经济影响、项目审批等实施条件发生变化，协议的履行及项目的实施可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

4、本投资合作协议涉及的项目投资额、达产后产能等数值并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

5、本次投资合作协议涉及的投资规模相对较大，对公司的项目管理、资金管理能力提出较高的要求，存在一定的项目资金安排及管理风险。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

公司将根据投资事项的进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续的相关公告。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、《项目投资合作协议》。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十三日